证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-016

深圳中科飞测科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年4月3日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2025年3月23日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

本报告真实准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。同意《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年年度报告》《深圳中科飞测科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

《2025年度财务预算报告》是公司根据2025年度生产经营和发展计划，以2024年度的经营业绩为基础，本着求实稳健的原则而编制的。同意《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制的截至2024年12月31日的《深圳中科飞测科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的相关规定，内容属实、完整，符合公司及全体股东的利益。同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于公司及子公司2025年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》

公司及子公司2025年度向相关金融机构申请授信借款额度事项是综合考虑公司及子公司的经营发展需要而做出的，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意《关于公司及子公司2025年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次公司为全资子公司提供担保符合实际需求，有利于生产经营稳健开展。本事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

（十）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

参考国内同行业监事的薪酬水平，结合公司实际情况，在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2025年4月4日

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-017

深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-1,152.51万元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币21,334.57万元。

经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月3日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2025年4月4日

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-020

深圳中科飞测科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]367号文批复，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月首次公开发行人民币普通股（A股）8,000.00万股，每股发行价为23.60元，应募集资金总额为人民币188,800.00万元，根据有关规定扣除发行费用18,961.34万元后，实际募集资金净额为169,838.66万元。该募集资金已于2023年5月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2023]32719号”《验资报告》。

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据相关规定及《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户。

2023年5月及6月，公司与中国银行股份有限公司深圳市吉支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海银行股份有限公司深圳分行和宁波银行股份有限公司深圳分行签署资金监管协议，资金监管协议与上海证券交易所的范本不存在重大差异，资金监管协议的履行不存在问题。

为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司于2024年10月30日召开董事会审议并通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，同意注销部分募集资金专户。截至2024年12月31日，募集资金专户注销的具体情况如下：

开户银行	银行账号	注销日期
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行	44250100000800005439	2024年12月3日
兴业银行股份有限公司深圳宝安支行	337060100100544110	2024年12月24日
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行	4000103929100801232	2024年12月17日
上海银行深圳前海分行	03005344408	2024年12月12日
宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000445229	2024年12月5日

注：截至2024年12月31日，募集资金专项账户“745877261923”、“754977254881”尚在办理注销手续。

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	169,838.66
减：投入募集资金项目金额	86,785.68
减：超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额	40,204.65
加：理财收益	1,795.16
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,043.95
截至2024年12月31日募集资金余额	45,687.44
其中：期末未到期理财产品	13,000.00
实际募集资金专户余额	32,687.44

截至2024年12月31日止，该次募集资金的存储情况如下：

单位：万元

存放银行	银行账号	余额
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	769277071129	17,877.70
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	8110301012100684395	8,551.57
中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	8110301013000682608	6,257.52
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	15201412318833	0.65
招商银行股份有限公司深圳红山支行	755942306110108	—
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	754977254881	—
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	745877261923	—
合计		32,687.44

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日止，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金126,990.33万元（含置换前期预先投入部分），其实际使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2024年12月31日止，除增加募投项目投资规模外，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

随着公司经营规模以及产品市场需求的持续快速增长，原“高端半导体质量控制设备产业化项目”建设方案预计无法充分保障公司未来高端半导体质量控制设备生产及研发需要。为了更好地服务于公司未来发展，公司拟增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模。

2023年12月15日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司使用超募资金30,877.70万元增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模，本次增加投资规模后项目总投资额由30,895.84万元调增为61,773.54万元，募集资金投入金额由30,800.00万元增加至61,677.70万元。具体内容详见公司于2023年12月16日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的公告》（公告编号：2023-026）。

2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告“附表1：前次募集资金使用情况对照表”。

“高端半导体质量控制设备产业化项目”的差异主要原因系项目处于建设期，募集资金将继续用于实施承诺项目所致；“研发中心升级建设项目”、“补充流动资金”差异主要原因系将累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、募投项目和发行费用先期投入及置换情况

截至2023年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为13,422.23万元，符合条件可以使用募集资金置换的金额为13,422.23万元。公司于2023年6月14日分别召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,422.23万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2023]34265号”《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》。具体内容详见公司于2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。截至2024年12月31日止，上述募集资金已于募集资金到位后6个月内全部置换完毕。

2、使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

公司于2023年10月26日召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-018）。截至2024年12月31日止，公司涉及使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为22,823.80万元。

（五）闲置募集资金情况说明

1、公司使用闲置募集资金的情况

公司于2023年6月14日分别召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币140,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于2024年6月4日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月5日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

截至2024年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为13,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

金融机构	理财类型	起息日	到期日	金额	利率
中国银行股份有限公司深圳大芬支行	可转让大额存单	2023/7/14	2026/7/14	13,000.00	2.90%
合计				13,000.00	/

2、公司尚未使用募集资金情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金未使用金额为45,687.44万元（其中包含募集资金利息收入扣减手续费净额及理财收益2,839.11万元），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的26.90%，未使用完毕的原因主要系根据项目建设及资金支付进度，尚未使用完毕，剩余资金将按计划继续用于募集资金项目。

（六）前次募集资金使用的其他情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款情况

2023年6月14日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币20,500.00万元的超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额69,838.66万元的比例为29.35%。具体内容详见公司于2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-003）。

2023年7月3日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。

2024年6月4日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币19,307.74万元（截至2024年5月31日账户余额，含账户利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，此金额占超募资金总额（69,838.66万元）比例为27.65%。具体内容详见公司于2024年6月5日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2024-028）。

2024年6月25日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。

截至2024年12月31日，公司涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额为40,204.65万元。

2、使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目情况

2023年6月14日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金10,600.00万元向全资子公司广州中科飞测实缴注册资本并提供20,200.00万元借款以实施“高端半导体质量控制设备产业化项目”。根据项目实施需要逐步拨付（借款不计息），借款期限为实际借款之日起3年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还。到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。具体内容详见公司于2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）。

2024年6月4日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“高端半导体质量控制设备产业化项目”拟投入募集资金金额的情况下，公司拟通过提供借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司广州中科飞测科技有限公司（以下简称“广州中科飞测”）的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。前述借款不计利息，借款期限为实际借款之日起3年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议借款可自动续期。具体内容详见公司于2024年6月5日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-029）。

截至2024年12月31日止，公司使用募集资金向广州中科飞测提供借款14,700.00万元，使用募集资金向广州中科飞测实缴注册资本为10,600.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心升级建设项目”不直接产生经济效益，该项目建设完成后，公司研发实力和创新能力将得到提升，为公司前沿技术的开发提供技术支撑，增强公司整体的盈利能力和核心竞争力，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况不存在与已公开披露信息有差异的情形。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025年4月4日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

编制单位：深圳中科飞测科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金净额：	169,838.66					已累计使用募集资金总额：			126,990.33		
变更用途的募集资金总额：	30,877.70					各年度使用募集资金总额：			126,990.33		
变更用途的募集资金总额比例（%）：	18.18					2023年			67,918.59		
						2024年			59,071.74		
投资项目			募集资金投资总额			截至2024年12月31日止募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期（或项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资与募集后承诺投资金额的差额		
1	高端半导体质量控制设备产业化项目	高端半导体质量控制设备产业化项目	30,800.00	61,677.70	16,910.15	30,800.00	61,677.70	16,910.15	－44,767.55		不适用
2	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	14,200.00	14,200.00	14,278.60	14,200.00	14,200.00	14,278.60	78.60		已完成
3	补充流动资金	补充流动资金	55,000.00	55,000.00	55,596.93	55,000.00	55,000.00	55,596.93	596.93		不适用
4	超额募集资金净额	超额募集资金净额	69,838.66	38,960.96	40,204.65	69,838.66	38,960.96	40,204.65	1,243.69		不适用
合计			169,838.66	169,838.66	126,990.33	169,838.66	169,838.66	126,990.33	－42,848.33		—

注：高端半导体质量控制设备产业化项目：公司于2023年12月15日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司使用超募资金30,877.70万元增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模，募集资金投入金额由30,800.00万元增加至61,677.70万元。具体内容详见公司于2023年12月16日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中科飞测关于使用超募资金增加募投项目投资规模的公告》（公告编号：2023-026）。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年12月31日

编制单位：深圳中科飞测科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年	2024		
1	高端半导体质量控制设备产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司代码：688361 公司简称：中科飞测

深圳中科飞测科技股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,152.51万元。综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案已经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中科飞测	688361	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	古凯男	无
联系地址	深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园1301号	无
电话	0755-26418302	无
传真	0755-23199950	无
电子信箱	IR@skyverse.cn	无

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主营业务概述

报告期内，公司专注于高端半导体质量控制领域，为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。

在设备产品方面，公司通过在光学检测技术、大数据检测算法和自动化软件领域的自主研发和不断创新，在多项半导体质量控制设备关键核心技术上达到国际领先水平，形成了集成电路制造过程中所有关键工艺环节所需的主要种类设备产品组合，使得公司能够为不同类型的集成电路客户提供全面覆盖的检测和量测设备供应保障，支持客户的量产工艺需求和未来工艺研发需求；

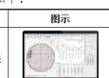
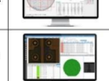
在智能软件产品方面，公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上，形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品，这些软件产品能够在检测和量测设备的基础上进一步为客户在良率管理中赋能，形成完整的质量控制设备和智能软件相结合的良率管理闭环，为客户实现最大化的质量控制对良率管理的提升效果。

2、公司主要产品情况

报告期内，公司专注于高端半导体质量控制领域，主要产品涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。

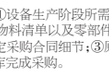
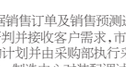
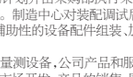
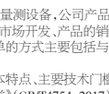
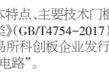
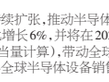
（1）检测设备

公司检测设备的主要功能系检测晶圆表面或电路结构中是否出现异质情况，如颗粒污染、表面划伤、开短路等对芯片工艺性能具有不良影响的特征性结构缺陷，具体情况如下：

产品名称	图示	产品性能
无图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于硅片的出厂品质管控、晶圆的入厂质量控制、半导体制程工艺和设备的污染监控，该系列的设备能够实现无图形晶圆表面的缺陷计数，识别缺陷的类型和空间分布。
图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于晶圆表面亚微米量级的二维、三维图形缺陷检测，能够实现在图形电路上的全类型缺陷检测，拥有多模式明/暗照明系统、成像系统，多种放大倍率镜头，适应不同检测精度需求，能够实现高速自动对焦，可适用于面型变化较大翘曲晶圆。
明场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于晶圆表面多种节点的图形晶圆的明场缺陷检测，拥有多模式明照系统、成像系统，多种放大倍率镜头，适应不同检测精度需求，能够实现高速自动对焦，可适用于不同类型晶圆。
暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备系列		主要应用于复杂图形晶圆表面纳米量级缺陷检测，采用深紫外激光暗场扫描与成像探测技术，实现复杂图形晶圆表面缺陷的快速检测与分类功能。

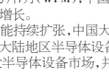
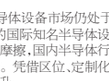
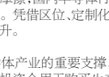
（2）量测设备

公司量测设备的主要功能系对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出量化描述，如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌、套刻精度等物理性参数的量测。在精密加工领域，量测设备主要功能是精密结构件的三维尺寸量测，具体情况如下：

产品名称	图示	产品性能
三维形貌量测设备系列		主要应用于晶圆上纳米级三维形貌测量、线宽测量和TSV孔洞量，配合图形晶圆智能化特征识别和流程控制、晶圆传片和数据通讯等自动化平台。
介质膜厚量测设备系列		主要应用于晶圆上纳米级单/多层薄膜、光刻胶等厚度测量，采用椭圆偏振技术和光谱反射技术实现高精度薄膜膜厚、n-k值的快速测量。
金属膜厚量测设备系列		主要应用于晶圆上金属膜厚度和硬掩膜层厚度测量，采用飞秒超声和差分技术，实现高精度膜厚、声速和沿柱比的快速测量。
套刻精度量测设备系列		主要应用于电路制作中不同层之间图案对图案对齐的误差测量，并将数据反馈给光刻机，帮助光刻机优化不同层之间的图案对齐误差，从而避免工艺中可能出现的问题。
光学关键尺寸量测设备系列		主要对集成电路前道制程中的扩散、薄膜沉积、研磨、刻蚀、光刻等工艺中的关键尺寸进行高精度和高速度的测量。
3D曲面玻璃量测设备系列		主要应用于3D曲面玻璃等构件的轮廓、弧高、厚度、尺寸测量，采用光谱共焦技术，实现高精度、高速度的非接触式测量。搭载可配置的全自动测量软件工具和完整的测试及结果分析界面。

（3）良率管理软件

公司将人工智能和大数据技术应用到半导体质量控制数据上，形成了一系列提升高端半导体制造良率的软件产品，这些软件产品能够在检测和量测设备的基础上进一步为客户在良率管理中赋能，形成完整的质量控制设备和智能软件相结合的良率管理闭环，为客户实现最大化的质量控制对良率管理的提升效果，具体情况如下：

产品名称	图示	产品性能
良率管理系统		通过综合运用统计分析和人工智能技术，以及可以根据客户需求定制化的软件工作流，为客户提供包括全维度数据管理、缺陷分类和统计分析、智能根因分析、虚拟量测、交叉分析和良率预测等在内的良率管理功能。
半导体缺陷自动分类系统		通过对接客户产线上的所有缺陷检测设备，将设备获取到的缺陷数据按照缺陷的尺寸、形态、位置、聚类情况、整体分布特征等进行自动分类，并且能够追溯和统计缺陷的发生频率和条件，帮助在缺陷层面管理和控制良率。
光刻套刻分析反馈系统		实现对光刻机、套刻精度量测设备、晶圆测曲量测设备、电子束关键量测设备等多种类、多品牌机型的数据进行整合分析和建模，帮助客户及时监控和优化光刻工艺的偏差，同时通过高阶模型补偿等功能来实现对光刻机光刻套刻偏移量的准确控制，有效地提升光刻机光刻工艺的良率水平。

自成立至今，公司始终坚持自主研发和自主创新原则，持续提升技术创新与产品创新能力，未来将继续深耕集成电路领域，以行业前沿技术与市场需求为导向，不断丰富产品种类及拓宽产品市场覆盖广度和深度。随着公司业务不断扩大，公司产品种类持续增加。

2.2 主要经营模式

1、研发模式

公司始终坚持自主研发、自主创新的研发模式，已逐步构建起了一套集研发、生产、销售于一体的创新机制。公司研发以设备研发和相关